

2024年6月3日

独立行政法人日本学生支援機構が発行する
「ソーシャルボンド」への投資について

東邦電機工業株式会社(代表取締役社長:村田章臣、以下「当社」という)は、このたび、独立行政法人日本学生支援機構(以下、「同機構」という)が発行するソーシャルボンド(第75回日本学生支援債券、以下「本債券」という)への投資を決定しましたので、お知らせします。

「ソーシャルボンド」とは、社会的課題の解決に資するプロジェクト(ソーシャルプロジェクト)の資金調達のために発行される債券のことであり、グリーンボンドとともに、ESG⁽¹⁾投資の対象となります。同機構は、2023年4月、ソーシャルファイナンス・フレームワークについて、ICMA(International Capital Market Association/国際資本市場協会)が定義するソーシャルボンド原則に適合する旨、日本格付研究所(JCR)からセカンド・パーティー・オピニオンを取得しており、本債券は「ソーシャルボンド」として発行されます。

本債券の発行による調達資金は、同機構が担う奨学金事業の内、貸与奨学金の財源として活用されます。奨学金事業は、日本国憲法第26条や教育基本法第4条に定められる「教育の機会均等」や、国連の持続可能な開発目標(SDGs)⁽²⁾の内、目標4「すべての人に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する。」の達成に資する等、我が国の教育面の課題解決に貢献します。

当社は、本債券を始めとしたグリーンボンド・ソーシャルボンドへの投資を継続的に実施することで、今後も社会的責任を果たして参ります。

<本債券の概要>

銘柄	第75回日本学生支援債券
年限	2年
発行額	300億円
発行日	令和6年6月7日

- (1) ESGとは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の英語の頭文字を合わせた言葉。「ESG投資」とはこれらの要素を重視・選別して行う投資のこと
- (2) 持続可能な開発目標(SDGs)とは、2015年9月の国連持続可能な開発サミットにて採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が掲げる、加盟各国が2030年までに達成すべき17の目標と169のターゲットのこと

以上